

## 3次元積層造形後処理加工技術研究分科会 (3DP-RC)

第4回  
(通算第12回)  
開催案内

### 3次元積層造形ビジネスの国際動向と 国プロにおける最新造形技術

Ver.2019.1.29

主催：3次元積層造形後処理加工技術研究分科会

幹事 鈴木 教和 (名古屋大学)

木下 正治 (キノシタ・コンサルティング)

土肥 俊郎 (九州大学/榑Doi Laboratory)

原 成利 (リンク)

森永 均 (フジミインコーポレーテッド)

3次元積層造形 (3D Printing) の産業応用は多岐にわたり、様々な素材や形状を対象として実用化が検討される中、積層段差を伴う表面の後処理加工技術の重要性は増しています。「3次元積層造形精密後処理加工技術勉強会」として本会の前身が誕生し、2018年度からは研磨加工とその関連技術に造詣の深い「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会 ((公社) 精密工学会)」(略称：プラナリ研) の「3次元積層造形後処理加工技術研究分科会 (3DP-RC)」として活動しています。今回は第4回研究会 (通算 12 回) となります。研究会のテーマは「3次元積層造形ビジネスの国際動向と国プロにおける最新造形技術」です。第一線の研究者・技術者に最新技術について情報提供をいただきます。まず、3次元積層造形の国際的な技術動向と装置関連メーカーの視点、およびビジネス応用の具体例について俯瞰的に紹介いただき、本研究会の関係者が目指すべき方向性について勉強することになります。次に、内閣府が推進する「SIP 革新的設計生産技術」の一環として推進されている「超 3D 造形技術プラットフォームの開発と高付加価値製品の創出」の最新の成果をご紹介いただき、国内最高峰の技術動向を探ってみたいと思います。著名な企業家・研究者にじっくりとお話しいただき、議論を交わす良い機会です。奮って、ご参加ください。

なお、本案内はこれまでに本勉強会に関してコンタクトさせていただきました方々、およびプラナリ研会員の皆様へ送付しております。本分科会はプラナリ研の活動の一部として行うものです。プラナリ研会員の方々には、同日開催のプラナリ研・研究会も含めて参加費無料となりますので、非会員の皆様におかれましては是非ご入会いただきたくどうぞよろしくお願いいたします。なお、分科会のみの参加をご希望される場合にも、プラナリ研の規約に従い都度参加費をお支払いいただいて参加していただくことが可能です。(詳しくは、事務局にお問い合わせください。) 積極的な参加をお待ちしております。

日 時： 2019年2月12日(火) 9:40～11:30(3DP-RC)  
12:40～17:00(プラナリ研・総会講演会)  
17:15～19:00(情報交換会)

開催場所： プラザエフ 7階「カトレア」  
(〒102-0085 東京都千代田区六番町15, JR「四ツ谷駅」より徒歩1分)  
(詳細は最終頁のアクセス地図をご参照ください。)

---

---

## 講演会テーマ 「3次元積層造形ビジネスの国際動向と国プロにおける最新造形技術」

9:40-9:45 開会挨拶 事務局

9:45-10:35 「Global Trends in 3D Printing」

3D Printing Corporation CEO Alexander De Vore

A broad look at many of the large movements inside the 3D Printing industry from around the world. We break down the industry into three categories: 1) 3D printing technology trends 2) 3D Printing vendor focuses and future direction 3) 3D printing business application and client cases. Finally, the presentation is summarized with an industry roadmap of the next 5 years and how this might relate to Japanese businesses.

10:35-11:25 「超高精細・微細3Dプリンティングの開発と応用 -SIPプロジェクトの最新成果とオープンイノベーション-」

横浜国立大学 大学院工学研究院 教授 丸尾 昭二

最も高精細な3Dプリンティング技術であるマイクロ光造形法は、フォトリソ、医療、マイクロマシンなどさまざまな分野に応用されている。本発表では、マイクロ光造形法の最近の進展と、我々の内閣府SIPプロジェクトの最新成果を報告します。さらに、微細な3D造形とめっきや熱処理、転写などのポストプロセスとの融合による機能デバイスの創製について紹介し、オープンイノベーションによる高付加価値製品の創出に向けた今後の展開について述べます。

11:25-11:30 連絡事項

-----

お昼休憩(40分)

-----

12:40-17:00 プラナリゼーションCMPとその応用技術専門委員会  
第171回研究会「デバイスメーカー講演特集」

※詳細は開催案内をご覧ください (<http://www.planarization-cmp.org/>)

-----

17:15-19:00 情報交換会(8階「スイセン」)

-----

※詳細は開催案内をご覧ください (<http://www.planarization-cmp.org/>)

**参加費：**

1. 企業会員：無料（年会費 100,000 円）
  2. 官学会員：無料（年会費無料・要登録）
  3. 非会員：30,000 円（今回の研究会のみの参加費）
- ※ご入会検討でお試し参加される場合、初回のみ一人様 15,000 円でご参加頂けます。  
※参加費にはプロシーディング代、情報交換会費が含まれます。  
※人数確認のため会員方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。  
※準備の都合上、情報交換会ご参加有無について必ず記入をお願いいたします。

参加の申し込みは「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会」の **ウェブページ (<http://www.planarization-cmp.org/>)** をご利用いただくのが便利です。下記の申込書をメールまたは FAX にて事務局にお送りいただくこともお手続きいただくことができます。



お申込み・お問合せ先：「CMP 専門委員会」事務局（三上）行き  
TEL：03-5117-2225, FAX：03-5117-2223, E-mail：[mikami@global-net.co.jp](mailto:mikami@global-net.co.jp)

**2019年2月12日（火）開催 第4回研究会, 第171回研究会 参加申込書**  
□会員／□一般（いずれかにチェックしてください）

氏名			
勤務先・所属			
参加内容 (参加されるものに ○を付けて下さい)	3DP-RC (午前) 第4回研究会	プラナリ研 (午後) 第171回研究会	情報交換会
連絡先	住所		
	TEL	FAX	
	E-mail		

**講演に関する問合せ連絡先：**

鈴木教和 名古屋大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 准教授  
〒464-8603 名古屋市千種区不老町  
TEL：(052) 789-4491 FAX：(052) 789-3107 e-mail：[nsuzuki@mech.nagoya-u.ac.jp](mailto:nsuzuki@mech.nagoya-u.ac.jp)

